

## Inhalt

<b>Vorwort .....</b>	17
<b>Welche EMV-Regeln sind bei der Anwendung und Herstellung von Steckverbindern zu beachten?</b>	
Helmut Katzier .....	18
<b>Antriebssysteme: Einfluss der Motorleitung auf EMV und Effizienz</b>	
Stefan Hilsenbeck .....	26
<b>Board-to-Board-Steckverbinder für hybride Anwendungen Daten / Signale / Power</b>	
Thomas Schulze, Arndt Schafmeister .....	36
<b>Konvergenz in der SPE-Connectivity am Beispiel PROFINET</b>	
Andreas Huhmann .....	46
<b>Der einheitliche SPE-Steckverbinder – Status und Auswirkungen für die Anwender</b>	
Tim Kindermann, Thomas Keller .....	55
<b>Laserstrukturierung von Stanzgittern für mediendichte Steckverbinder für Batterieeinheiten, Leistungselektronik und Kühlsysteme für E-Antriebe</b>	
Benjamin Hertweck .....	66
<b>USB-C 3.1 als intelligente Stromversorgungs- und Ladeschnittstelle</b>	
Fabian Altenbrunn .....	67
<b>Rundsteckverbinder für die Leiterplatte</b>	
Volker Müller, Patrick Schmidt .....	69
<b>Elektrische Luft- und Kriechstreckenanalyse mit AutoClear</b>	
Urs Simmler .....	74
<b>EMV und die Simulation, die eigentlich keiner machen möchte</b>	
Maximilian Depta .....	76
<b>Neueste Technologien in der Metall-Kreislaufwirtschaft der Steckverbinderindustrie</b>	
Thomas Frey .....	82
<b>Die Rolle der Steckverbinder in der KI-Revolution</b>	
Lars Klaproth .....	95
<b>Ermittlung von Ausfallraten für automobile Steckverbinder: Risiken und Chancen zugleich</b>	
Frank Ostendorf, Michael Ludwig, Thomas Fili .....	102
<b>Ultraschallschweißen von Al-Busbars mit Cu-Kontakten: Zuverlässigkeit der Verbindung unter Einhaltung der Norm IEC 60352-9</b>	
Christian Gregor .....	115
<b>Grenzformänderung und maximale Umformbarkeiten metallischer Werkstoffe für Steckverbinder in der Automobilindustrie</b>	
Niklas Utz .....	130

<b>Nachhaltige Herstellung von Rundsteckverbindern: Potenziale der umformtechnischen Fertigung für ökologische und wirtschaftliche Vorteile</b> Herman Voigts, Max Meerkamp, Martina Müller, Tim Hering, Thomas Bergs, Stefan Hoppe .....	137
<b>Metals and clad materials for electrical connectors in high performance applications</b> Björn Reetz, Andreas Frehn, Christian Hopf .....	152
<b>Ageing of plastics</b> Alexandre Chaillet .....	166
<b>Thunderbold &amp; USB-C: The power duo of high-speed connectivity</b> Andreas Pitzl .....	174
<b>Sustainable electroplating solutions: tin plating</b> Bernd Roelfs, Alexander Spörrer .....	179
<b>Ethernet anywhere, wie hybride Steckverbindersysteme die Automation verändern</b> Manuel Rüter .....	189
<b>Erfolg in neuen Märkten durch Dichtheitsprüfung von Steckverbindern</b> Joachim Lapsien .....	195
<b>MSA zur Optimierung der Qualitätskontrolle mittels Röntgenfluoreszenzanalyse</b> Konstantinos Panos, Omar Cheikh-Jumaa .....	210
<b>Basisseminare</b> .....	218
<b>Workshops</b> .....	226
<b>Bitte vormerken</b> .....	231